

2010-2011年全球及中国PCB行业研究报告



本报告只研究PCB硬板领域。

PCB是电子产业的基石，所有的电子用品都需要PCB来完成电路。PCB产业已经高度成熟，增长与下跌幅度都有限。2008、2009两年，PCB产业都因竞争激烈互相压价而产值萎缩。2010年电子行业反弹，PCB也只成长10.5%，而2011年预计成长只有5.1%。

一般功能型手机内部PCB板采用1HDI+2传统板+1HDI设计，外层为HDI，内层为传统板。中阶和高阶的智能型手机采用2+2+2和3+2+3设计，分别使用4层和6层HDI。另外，iPad1是1HDI+8传统板+1HDI，使用2层HDI。iPad2是3+4+3，一共使用6层HDI，即Any-Layer HDI，将厚度降到仅有0.88公分，iPad1厚度为1.34公分。

新款iPad能够较上一代薄型化1/3，最主要原因是HDI由原先传统多阶板进化为Any-Layer，且Any-Layer上钻孔密度更高，然因孔径过小，在进行全通孔必须以雷钻取代机钻。未来的iPhone 5会仿效iPad 2再轻薄化，全雷钻制程将持续发展。

2010年全球PCB硬板厂家收入（前20名）

	2009 年收入 (百万美元)	2010 年收入 (百万美元)
TRIPOD	1013	1361
UNIMICRON	980	1194
TTM	582	1184 (收购了美维)
CMK	959	1043
MEIKO	743	900
IBIDEN	747	832
FOXCONN PCB	750	810
惠亚	350	764
MULTEK	660	720
COMPEQ	569	707
HANNSTAR	587	696
AT&S	519	647
依利安达	435	599
日立化成	520	550
GCE	433	493
TPT	375	483
敬鹏	394	447
LG INNOTEK	340	443
WUS	334	442
南亚电	205	329

iPad 2全球主要供货商有四家，健鼎为台湾HDI主板唯一供货商，其余三家为美国的TTM、日本的IBIDEN、MEIKO。备选供应商全部为台湾厂家，分别是南电、金像电、华通、欣兴。

报告目录

第一章、PCB产业概况

- 1.1、PCB产业规模
- 1.2、PCB产业格局
- 1.3、PCB产业近况

第二章、PCB下游市场

- 2.1、手机
 - 2.1.1、全球手机市场规模
 - 2.1.2、手机品牌市场占有率
 - 2.1.3、智能手机市场与产业
 - 2.1.4、中国手机产业
- 2.2、笔记本电脑
 - 2.2.1、全球笔记本电脑市场规模与品牌格局
 - 2.2.2、平板电脑市场

第三章、PCB产业分析

- 3.1、手机PCB产业
 - 3.1.1、手机PCB厂家排名
 - 3.1.2、手机PCB配套关系
- 3.2、ANY-LAYER HDI
 - 3.2.1、Any-layer HDI定义

- 3.2.2、Any-layer HDI应用
- 3.2.3、Any-layer HDI供需
- 3.3、内存模块PCB
- 3.4、光电板
- 3.5、汽车电子PCB
- 3.6、笔记本电脑PCB
- 3.7、PCB钻孔机
- 3.8、PCB产业排名

第四章、PCB厂家研究

- 4.1、欣兴
- 4.2、华通
- 4.3、健鼎
- 4.4、瀚宇博德
 - 4.4.1、江阴瀚宇博德
- 4.5、名幸
- 4.6、CMK
 - 4.6.1、无锡希门凯
 - 4.6.2、瑞升科技
 - 4.6.3、旗利得电子
- 4.7、IBIDEN
- 4.8、大德电子
 - 4.8.1、大德GDS
- 4.9、TTM

- 4.10、耀华
- 4.11、金像电
- 4.12、AT&S
- 4.13、建滔
 - 4.13.1、依利安达
 - 4.13.2、科惠线路板
 - 4.13.3、扬宣电子
- 4.14、SIMMTECH
- 4.15、志超
- 4.16、依顿电子
- 4.17、敬鹏
- 4.18、LG INNOTEK
- 4.19、SEMCO
- 4.20、方正电路板
- 4.21、高德电子
- 4.22、定颖
- 4.23、惠亚
- 4.24、南亚电路板
- 4.26、深南电路
- 4.27、沪士电子
- 4.28、超声电子
- 4.29、MULTEK

图表目录

- 2006-2012年PCB产业产值
- PCB产业链
- 2010年PCB产业产值分布by technology
- 2010年PCB产业产值地域分布
- 2010年PCB产业产值下游应用分布
- 2009年1月-2011年1月北美PCB 订单量与出货量指数及订单出货比
- 2007-2013年全球相机手机像素分布
- 2007-2013年全球自动对焦相机手机出货量
- 2007-2014年全球手机出货量
- 2008年1季度-2010年4季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
- 2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量地域分布
- 2007年1季度-2010年2季度每季度全球手机出货量技术分布
- 2006-2010年全球CDMA/WCDMA手机出货量地域分布
- 2009-2010年全球主要手机品牌出货量
- 2009年1季度-2010年4季度全球五大手机厂家运营利润率
- 2010-2011年全球主要手机厂家智能手机出货量
- 2010年中国手机产量地域分布
- 2007-2013年全球笔记本电脑出货量与增幅
- 2010-2011年全球主要笔记本电脑厂家出货量
- 2008-2012年NETBOOK、iPad、平板电脑出货量
- 2010年NOKIA手机PCB供应商供应比例
- SAMSUNG手机PCB供应商供应比例

- 2010年LG手机PCB供应商供应比例
- 2010年ZTE手机PCB供应商供应比例
- 2010年RIM手机PCB供应商供应比例
- 2010年APPLE手机PCB供应商供应比例
- 2010-2011年Any-layer HDI应用分布
- 2010年内存PCB厂家市场占有率
- 2006年中国光电板主要厂家市场占有率
- 2010年笔记本电脑PCB主要厂家市场占有率
- 欣兴组织结构
- 2003-2011年欣兴收入与毛利率
- 2009年1季度-2010年4季度欣兴手机板出货量
- 2009-2010年欣兴收入下游应用分布
- 2010年3、4季度欣兴收入下游应用分布
- 欣兴关系企业联系图
- 2006-2011年华通收入与毛利率
- 2009年1季度-2010年4季度华通手机板出货量
- 2006-2011年健鼎收入与毛利率
- 2010年健鼎收入下游应用分布
- 瀚宇博德关系企业图
- 2006-2011年瀚宇博德收入与毛利率
- 2003-2011年瀚宇博德笔记本电脑PCB板市场占有率
- 瀚宇博德组织结构
- 瀚宇博德2009年1季度-2010年2季度收入下游应用分布
- 瀚宇博德2009年1季度-2010年2季度收入by layer

- 瀚宇博德2009年1季度-2010年2季度产能利用率
- 瀚宇博德2003-2010年3季度各厂产能
- 2005-2010年江阴瀚宇博德营业额与运营利润率
- 2006-2011财年名幸电子收入与运营利润率
- 2008财年-2011财年3季度名幸电子收入地域分布
- 2010财年、2012财年名幸电子收入下游应用分布
- 2010财年、2012财年名幸电子收入技术分布by layer
- 2005-2011财年CMK收入与运营利润率
- 2007-2011财年上半年CMK收入下游应用分布
- 2007-2011财年上半年CMK收入by layer
- 2007-2011财年上半年CMK收入地域分布
- 2006-2011财年IBIDEN收入与运营利润率
- 2006-2011财年3季度IBIDEN收入业务分布
- 2009-2011财年3季度IBIDEN运营利润业务分布
- 2008-2012年IBIDEN HDI板产量
- 2005-2011年大德电子收入与运营利润率
- 2009-2011年大德电子收入by business
- 2010年季度-2011年4季度大德电子收入by business
- 大德GDS收入与运营利润率
- 2007-2010年大德GDS收入业务分布
- TTM全球分布
- 1998-2010年TTM收入及历次收购
- 2009年1季度-2010年4季度TTM收入by technology
- TTM 2010年亚太地区收入下游分布

- TTM 2010年北美地区收入下游分布
- TTM主要客户
- 耀华组织结构
- 2006-2011年耀华收入与毛利率
- 2005-2011年金像电子收入与毛利率
- 2010年金像电收入下游分布
- 2006-2011年AT&S收入与EBITDA
- 2005-2010财年 AT&S收入地域分布
- 2009-2011财年 AT&S下游应用分布
- 2009-2011财年 AT&S收入地域分布
- 2002-2010年建滔化工收入与股东应占利润率
- 2008、2009财年建滔化工收入业务分布
- 建滔化工集团架构
- 依利安达公司架构
- 2005-2010年依利安达收入与运营利润率
- 2006-2010年依利安达收入地域分布
- 2006-2010年依利安达收入by layer
- 2009年底依利安达各厂产能
- 2004-2009年扬宣多层板产量
- 2004-2009年扬宣双面板产量
- SIMMTECH组织结构
- 2004-2011年SIMMTECH收入与运营利润率
- 2010年1季度-2011年4季度 SIMMTECH收入与运营利润率
- 2010年1季度-2011年4季度 SIMMTECH内存收入by speed

- 2010年1季度-2011年4季度 SIMMTECH载板 (Substrate) 收入类型分布
- 2004年1季度-2010年4季度SIMMTECH每季度载板与内存模块收入
- 2005-2010年SIMMTECH载板与内存模块产能利用率
- 2004年1季度-2010年4季度SIMMTECH每季度内存模块收入类型分布
- 2004年1季度-2010年4季度SIMMTECH每季度载板收入类型分布
- 2010年1季度-2011年4季度SIMMTECH载板与内存PCB产量
- 2010年1季度-2011年4季度SIMMTECH载板与内存PCB产能利用率
- 2004年1季度-2010年4季度SIMMTECH收入下游应用分布
- 2004-2010年SIMMTECH客户分布
- SIMMTECH厂区
- 2005-2011年志超收入与毛利率
- 2007-2010年依顿电子收入与毛利率
- 2005-2011年敬鹏收入与毛利率
- 2006-2011年LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2009-2012年LG INNOTEK收入产品分布
- 2009年4季度-2010年4季度LG INNOTEK PCB部门收入
- 2010年3季度-2010年4季度LG INNOTEK PCB下游应用比例
- 2010-2011年SEMCO收入部门分布
- 2010年1季度-2011年4季度SEMCO ACI事业部收入与运营利润率
- 方正集团组织结构
- 方正PCB组织结构
- 2004-2010年方正PCB收入
- 2010年方正PCB下游应用分布
- 方正重庆厂产能by technology

- 珠海方正一厂产能by technology
- 珠海方正三厂产能by technology
- 珠海方正五厂产能by technology
- 方正杭州二厂产能by technology
- 珠海方正四厂产能by technology
- 2005-2010年高德电子收入与运营利润
- 定颖组织结构
- 2006-2011年定颖收入与毛利率
- 2009-2012年定颖产能
- 2009-2012年定颖台湾产能
- 2009-2012年定颖昆山产能
- 2009-2012年定颖厦门产能
- 2006-2010年惠亚收入与运营利润率
- 2008-2010年惠亚收入业务分布
- 惠亚全球分布
- 2008-2010年惠亚集团收入下游应用分布
- 惠亚主要客户
- 惠亚2010年收入地域分布
- 南亚电路板组织结构
- 南亚电路板产能与全球分布
- 2007-2011年南亚电路板收入业务分布
- 2010年南亚电路板客户结构
- 深南电路组织结构
- 沪士电子组织结构

- 2007-2011年沪士电子收入与运营利润
- 2007-2010年沪士电子收入下游分布
- 2005-2011年超声电子收入与运营利润率
- 超声电子组织结构
- 2007-2010年超声电子收入业务分布
- 2007财年\2011财年伟创力收入下游应用分布
- 2009年4季度-2010年4季度伟创力收入下游应用分布

- 2010年1-4季度全球主要手机品牌出货量
- 2009年1季度-2010年3季度全球主要手机品牌收入市场占有率
- 2010年3季度全球智能手机操作系统出货量
- 2010年手机PCB厂家收入排名
- 2010年汽车电子PCB厂家收入市场占有率
- 笔记本电脑用PCB技术路线图
- 欣兴历年合并
- 欣兴2010年4季度产能产品(单位:K ft²/M) 4Q09 1H10 4Q10
- 欣兴主要子公司2009年财务数据
- 2009年华通主要子公司财务数据
- 2006-2010年健鼎产能
- 2009-2011财年名幸电子大陆子公司收入与运营利润率
- 2003-2010年无锡希门凯收入与产量
- 2007-2011年揖斐电电子收入
- 2004-2008年美维收入与运营利润
- 2005-2009年TTM收入与运营利润

- 美维中国工厂一览
- AT&S基地全球一览
- 2010年依利安达技术能力
- 2010年扬宣制程能力
- 2010年志超客户结构
- 2008-2011年志超产能
- 2007-2010年3季度 依顿电子产量
- 2007-2010年3季度 依顿电子产销量by layer
- 2007-2010年3季度 依顿电子收入by layer
- 2007-2010年3季度 依顿电子收入by application
- 2007-2010年3季度 依顿电子收入by region
- 2007-2010年3季度 依顿电子收入客户结构
- 2007-2010敬鹏各厂产能月产能(K SF)
- 方正HDI技术能力
- -2008-2010年惠亚主要客户
- 深南电路技术能力
- 2007-2009年沪士电子出货量by layer
- 2007-2009年沪士电子收入by layer
- 2010年沪士电子主要客户
- 2007-2009年超声电子产量

购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 8500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 183页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2011-03		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201103/24511234.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。